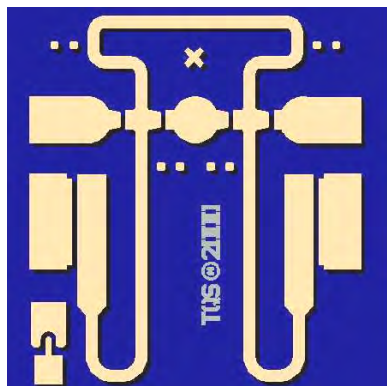


Wideband Dual Stage VPIN Limiter

TGL2201



Key Features

- 3-25 GHz Passive, High Isolation Limiter
- Low Loss < 0.5 dB , X-band
- Good Return Loss > 15 dB
- Flat Leakage < 18 dBm
- Input Power CW Survivability > 5W
- Integrated DC Block on both input and output
- Chip Dimensions: 1.1 x 1.1 x 0.1 mm

Primary Applications

- Military Radar
- LNA Receiver Chain Protection

Fixtured Measured Performance

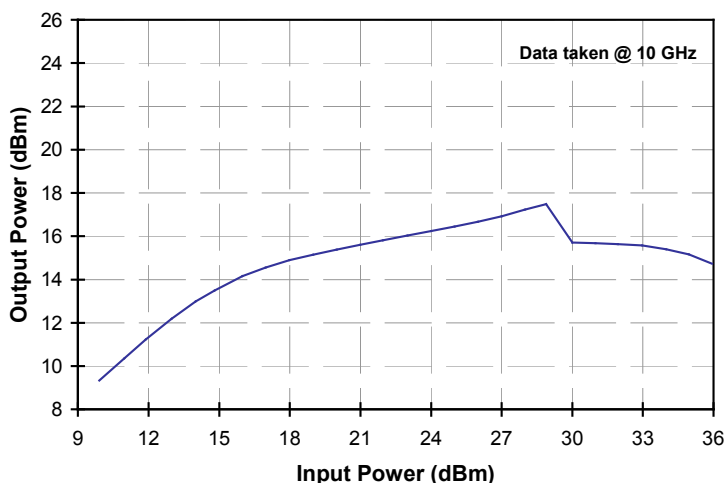
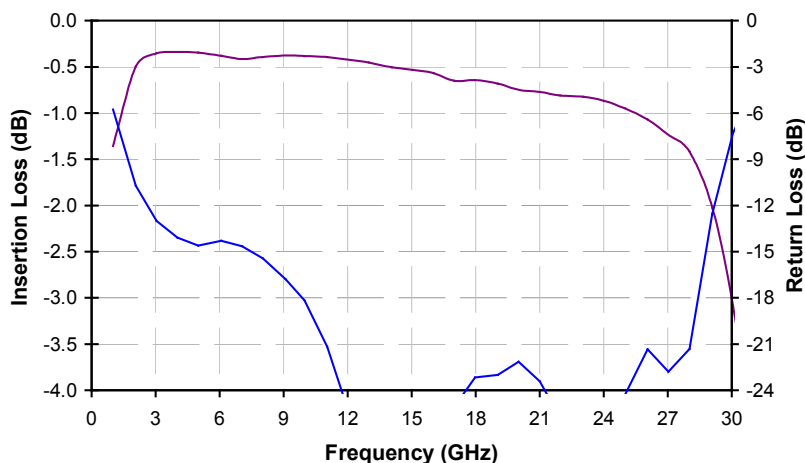


TABLE I
MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter 1/	Value
P _{IN}	Input Continuous Wave Power	37 dBm
T _M	Mounting Temperature (30 Seconds)	320 °C
T _{STG}	Storage Temperature	-65 to 150 °C

1/ These ratings represent the maximum operable values for this device

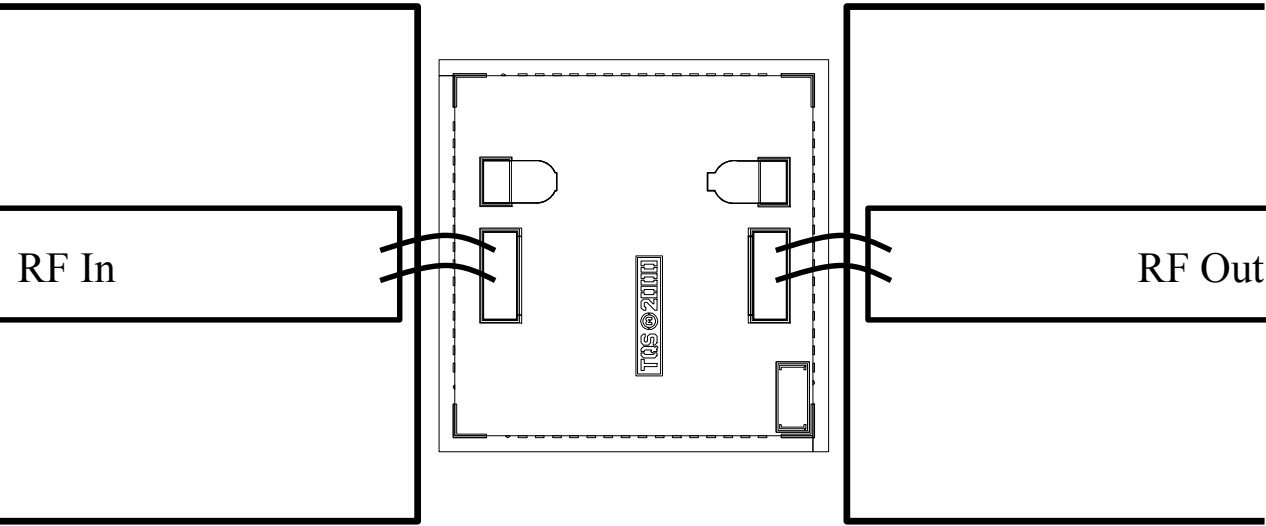
TABLE II
DC CHARACTERISTICS
(T_A = 25 °C)

Symbol	Parameter	Limit		Units
		Min	Max	
FWD_RES _(D1, D2, D3, D4)	Resistance Forward	1.9	3.9	Ohm
VREV _(D1,D4)	Reverse Voltage	-60	-30	V

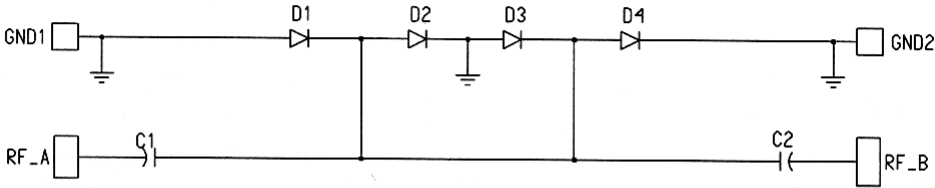
TABLE III
RF CHARACTERISTICS
(T_A = 25 °C)

Symbol	Parameter	Test Condition	Limit			Units
			Min	Typ	Max	
IL	Insertion Loss	F = 4-20 GHz	--	0.5	1.0	dB
IRL	Input Return Loss	F = 4-20 GHz	12	--	--	dB
ORL	Output Return Loss	F = 4-20 GHz	12	--	--	dB
PWR	Output Power @ P _{in} = 27 dBm	F = 6.0 GHz	--	--	20	dBm
		F = 16.0 GHz	--	--	20	dBm

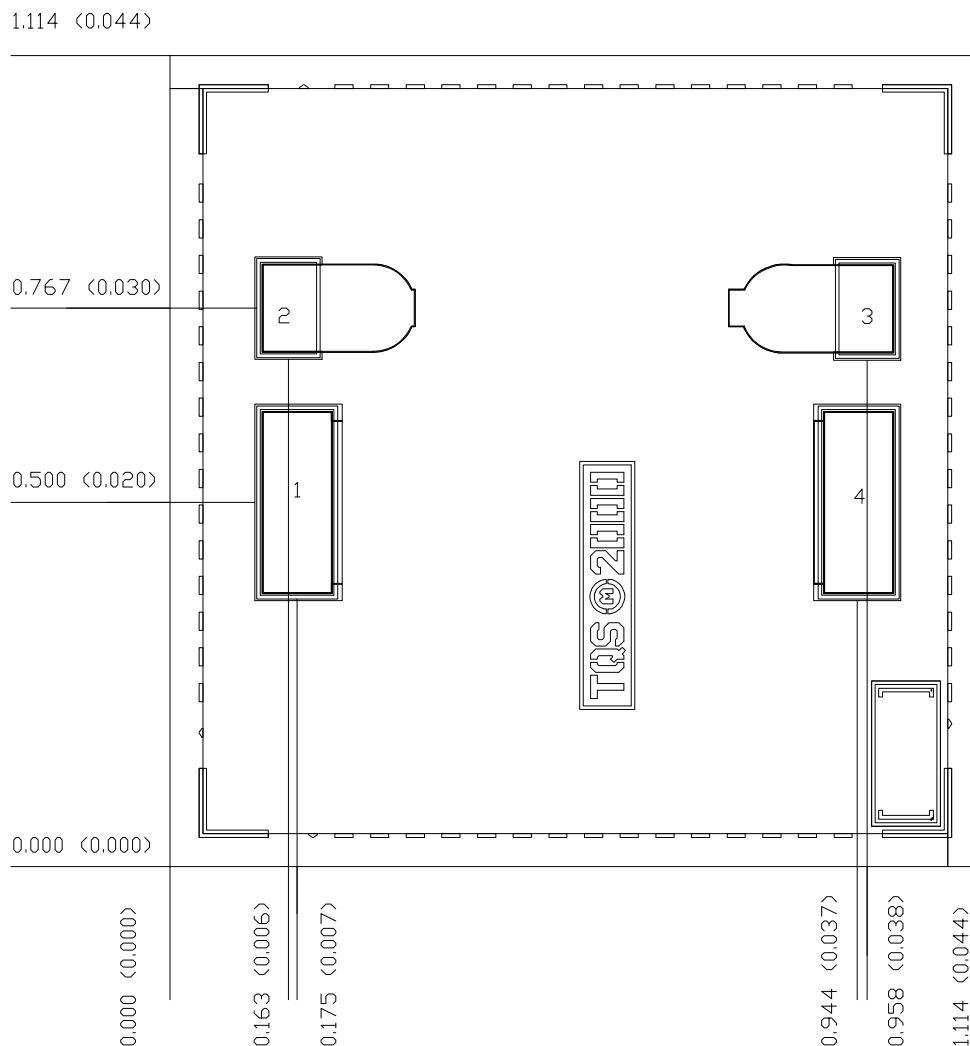
High Isolation Limiter Assembly



DC Schematic



Mechanical Drawing



Units: millimeters (inches)

Thickness: 0.100 (0.004) (reference only)

Chip edge to bond pad dimensions are shown to center of bond pad

Chip size tolerance: ± 0.051 (0.002)

GND IS BACKSIDE OF MMIC

Bond pad #1	(RF In)	0.096 x 0.250 (0.004 x 0.010)
Bond pads #2,3	(Gnd)	0.078 x 0.126 (0.003 x 0.005)
Bond pad #4	(RF Out)	0.096 x 0.250 (0.004 x 0.010)

GaAs MMIC devices are susceptible to damage from Electrostatic Discharge. Proper precautions should be observed during handling, assembly and test.

Assembly Process Notes

Reflow process assembly notes:

- Use AuSn (80/20) solder with limited exposure to temperatures at or above 300 °C for 30 sec
- An alloy station or conveyor furnace with reducing atmosphere should be used.
- No fluxes should be utilized.
- Coefficient of thermal expansion matching is critical for long-term reliability.
- Devices must be stored in a dry nitrogen atmosphere.

Component placement and adhesive attachment assembly notes:

- Vacuum pencils and/or vacuum collets are the preferred method of pick up.
- Air bridges must be avoided during placement.
- The force impact is critical during auto placement.
- Organic attachment can be used in low-power applications.
- Curing should be done in a convection oven; proper exhaust is a safety concern.
- Microwave or radiant curing should not be used because of differential heating.
- Coefficient of thermal expansion matching is critical.

Interconnect process assembly notes:

- Thermosonic ball bonding is the preferred interconnect technique.
- Force, time, and ultrasonics are critical parameters.
- Aluminum wire should not be used.
- Maximum stage temperature is 200 °C.

GaAs MMIC devices are susceptible to damage from Electrostatic Discharge. Proper precautions should be observed during handling, assembly and test.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А